

第 40 回 UV / EB 表面加工入門講座 (大阪)

期 日 : 2016 年 7 月 22 日 (金) 9 : 30 ~ 17 : 30

会 場 : 大阪市立工業研究所 大講堂 大阪市城東区森之宮 1-6-50

主 催 : 一般社団法人ラドテック研究会

協 賛 : 一般社団法人近畿化学協会・一般社団法人色材協会
一般社団法人日本接着学会・合成樹脂工業協会
一般社団法人有機エレクトロニクス材料研究会
フォトポリマー懇話会・日本放射線化学会 (予定・順不同)

< 講師と演題 >

- 1) 9 : 30 ~ 10 : 30 「UV 硬化技術総論」
大阪府立大学 白井 正充 氏
- 2) 10 : 45 ~ 11 : 45 「UV/EB 硬化用モノマーおよびオリゴマー」
大阪有機化学工業株式会社 石原 秀篤 氏
- 11 : 45 ~ 12 : 45 * * * * * 昼 食 * * * * *
- 3) 12 : 45 ~ 13 : 45 「光重合開始剤の種類と特性」
BASF ジャパン株式会社 鮫島 かおり氏
- 4) 14 : 00 ~ 15 : 00 「UV 照射光源と照射プロセス」
ヘレウス株式会社 河村 紀代子氏
- 15 : 00 ~ 15 : 15 ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ コーヒーブレイク ♪ ♪ ♪ ♪ ♪
- 5) 15 : 15 ~ 16 : 15 「電子線 (EB) 照射の基礎と工業利用の現状」
株式会社 NHV コーポレーション 岡崎 泰三 氏
- 6) 16 : 30 ~ 17 : 30 「紫外線硬化樹脂の硬化過程の測定法」
金沢大学 瀧 健太郎 氏

※各講演終了後、質問タイム (それぞれ 10 分) を設けます。

1. 参加費 個人会員（本人）無料
法人会員（2名まで）無料 3名から1名10,000円（消費税含）
非会員は1名20,000円（消費税含）
協賛団体に所属されている方は下記の通りとなります。
- 協賛団体所属の方：10,000円（消費税含）
注・上記参加費には、講演要旨集1冊を含みます。
2. 申込締切日 2016年6月30日（木）
3. 申込方法 添付申込書に必要事項をご記入後E-mailにてお申し込み下さい。
4. 入金方法 参加費は銀行振込にてお願い致します。
（尚、振込手数料はご負担下さい。）
振込先： みずほ銀行 麹町支店（銀行コード：0001 店番号：
021）
口座番号： 普通預金）1361387
口座名義： 一般社団法人ラドテック研究会
名義カナ： シャ）ラドテックケンキュウカイ
ご入金は開催日までにお願ひ申しあげます。
※一度ご入金された参加費は返金致しかねますので、あらかじめご了承下さい。
5. 参加証 ご入金確認後参加者本人宛お送り致します。
従ってお申し込み及びご送金が申込締切日以降で開催日が迫っている場合は参加証が届かない場合がありますので、参加受付番号等を事務局まで事前にお問い合わせ下さい。なお、領収書は振込受領書をもってかえさせていただきます。
6. 問合せ先 一般社団法人ラドテック研究会事務局
〒102-0082 千代田区一番町23-2 番町ロイヤルコート207
TEL：03-6261-2750 FAX：03-6261-2751
E-mail：staff@radtechjapan.org